

【原因・判断ポイント・発生工程】ネガタイプ A W F の不透明部についた傷によって出来たもの（露光焼付～ E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】负像 AWF 的不透明部位被划伤而引起的（曝光～ ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】A scratch on the opaque portion of a negative pattern phototool causes the defect. (Imaging - etching process)



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×

### 1-5-1-2 露光被り突起／曝光阴影的凸出 / Projected conductor by exposing light leakage

【特徴】回路導体面と同一高さのはみ出したようなシャープな突起。

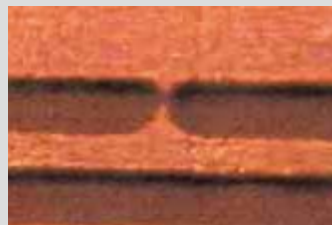
【特征】在导线面同样的高度有超出范围的锐利的凸出。

【Characteristics】A well defined conductor projection of the same thickness as that of the conductor which looks like an extended pattern.

【原因・判断ポイント・発生工程】ネガタイプフォトツールの不透明部の下に厚みのある異物が介在し、フォトツールが浮き上がった状態となり、露光被りを起こした為に出来たもの（露光焼付～ E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】在原图不透明部位的下面夹杂较厚的杂物，原图成为鼓起状态，妨碍曝光所造成的（曝光～ ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】A thick foreign object exists under the opaque portion of a negative pattern phototool and lifts the phototool, leading to light leakage and the defect. (Imaging - etching process)



【コメント】  
短絡と同居  
顕微鏡倍率 × 40

【注釋】  
与短路并存  
显微镜倍率 × 40

【Comments】  
Coexisting with short  
Magnification: ×40



【コメント】  
短絡と同居  
顕微鏡倍率 × 40

【注釋】  
与短路并存  
显微镜倍率 × 40

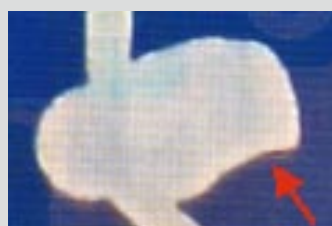
【Comments】  
Coexisting with short  
Magnification: ×40

### 1-5-1-3 スカム突起／余膜的凸出 / Projected conductor by scam

【特徴】回路導体表面と同一レベルで D F R 剥離片形状の突起

【特征】在线路面有 DFR 余膜形状的凸出。

【Characteristics】A conductor projection of the same thickness as that of the conductor in the shape of peeled dry film debris



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×